



# Minister Rozwoju i Technologii

---

Znak pisma: DIP-IX.054.4.2024  
Warszawa, 18 lipca 2024 r.

Pan  
Szymon Hołownia  
Marszałek Sejmu RP

**Dotyczy:** odpowiedzi na interpelację poselską nr 3250 Pana Daniela Milewskiego, Posła na Sejm RP

**Szanowny Panie Marszałku,**

poniżej przedstawiam stanowisko Ministra Rozwoju i Technologii w stosunku do zadanych w interpelacji poselskiej pytań.

**1. Jakie konkretne działania podejmuje rząd w celu promowania rozwoju elektroniki i fotoniki w Polsce?**

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach swoich działań statutowych od ok. 2 lat prowadzi intensywne działania promocyjne ukierunkowane na rozwój strategicznego sektora półprzewodników. Działania te obejmują organizację misji handlowo-inwestycyjnych, głównie przy współpracy z partnerami z Tajwanu oraz organizację Pawilonu Polskiego z udziałem wiodących polskich firm na największych na świecie targach branży półprzewodnikowej SEMICON TAIWAN w 2023 i 2024 r.

W Pawilonie Polskim na targach SEMICON TAIWAN 2023 uczestniczyło 6 firm, w tym: VIGO Photonics, DCD, XTPL, QNA, Fluence, Ensemble3, a także Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. W tym roku planowana jest kolejna edycja Polskiego Pawilonu podczas targów SEMICON TAIWAN 2024. PAIH jest obecnie na etapie rekrutacji firm na stoisko.

Organizacja misji z Tajwanem zaowocowała bliską współpracą z tajwańskim funduszem inwestycyjnym Taiwan Capital, który angażuje się w inicjowanie wspólnych przedsięwzięć między firmami polskimi i tajwańskimi, wspiera nawiązywanie współpracy między instytucjami branżowymi w Polsce i na Tajwanie oraz angażuje się kapitałowo w firmy technologiczne z naszego regionu.

PAIH od maja 2023 r. jest również członkiem globalnej organizacji branży półprzewodnikowej SEMI, która reprezentuje środowisko branży półprzewodników z całego świata. Członkostwo ułatwia nawiązywanie kontaktów branżowych na arenie międzynarodowej.

Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, jest jednym z 15 sektorów o potencjale eksportowym i innowacyjnym, który został objęty wsparciem w ramach projektu o pn. „Umiejdzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”, działanie 2.26 Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG). Promocją tego sektora w latach 2024-2029 została powierzona Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości, która w konsultacji z przedsiębiorcami przygotowała program promocji sektora elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki.

Głównym celem realizacji programu jest prezentacja polskiej oferty produktów i usług sektora elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki wśród partnerów zagranicznych oraz promocja Polski jako kraju wytwarzającego zaawansowane technologie i usługi, oferującego interesujące i innowacyjne rozwiązania, posiadającego potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych.

W projekcie realizowane są działania promocyjne, w ramach których promowany jest sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki oraz polska gospodarka poprzez: organizację stoisk narodowych na wybranych 10 zagranicznych imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym m.in. w: Niemczech, Japonii i Tajwanie, kampanię informacyjno-promocyjną, a także przygotowanie raportu w języku angielskim zawierającego prezentację polskiego sektora elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki ze wskazaniem jego potencjału i przewag konkurencyjnych.

Mali i średni przedsiębiorcy w ramach komplementarnego działania 2.25 FENG Promocja marki innowacyjnych MŚP, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, mogą uzyskać dofinansowanie do udziału w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy, udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączonych z udziałem przedsiębiorcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji, jak również dofinansowanie do realizacji kampanii promocyjnych.

## **2. Czy istnieją programy wspierające badania i rozwój w dziedzinie elektroniki i fotoniki, zarówno na poziomie naukowym, jak i przemysłowym?**

Obecnie główne działania Rządu RP w dziedzinie mikroelektroniki i fotoniki wpisują się w proces wdrażania European Chips Act, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1781 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustanowienia ram dotyczących środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2021/694 (akt w sprawie czipów), które weszło w życie w dniu 21 września 2023 r.

W odpowiedzi na wyzwania związane z zakłóceniami łańcuchów dostaw i potrzebą budowania suwerenności technologicznej UE, Komisja Europejska zaproponowała European Chips Act, mający na celu mobilizację zasobów finansowych, wsparcie badań i rozwoju oraz budowę nowoczesnych fabryk półprzewodników.

European Chips Act zakłada utworzenie europejskiej sieci centrów kompetencyjnych, które będą wspierać przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy (MŚP), uczelnie oraz instytuty badawcze w dostępie do nowoczesnych technologii półprzewodnikowych. Centra te mają zapewniać dostęp do zaawansowanych narzędzi i infrastruktury badawczej, a także oferować szkolenia i programy rozwoju kompetencji, co ma na celu podniesienie kwalifikacji kadry oraz ułatwienie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Kolejnym istotnym elementem European Chips Act jest rozwój linii pilotażowych, które umożliwiają testowanie i walidację nowych technologii półprzewodnikowych przed ich wprowadzeniem do masowej produkcji. Linie te mają na celu przyspieszenie procesu innowacji, skrócenie cyklu rozwoju produktów oraz zapewnienie Europie zdolności do produkcji zaawansowanych technologii na dużą skalę (Chips JU). Inicjatywa ta wzmacnia również współpracę między państwami członkowskimi, przemysłem i instytucjami badawczymi, co ma kluczowe znaczenie dla budowy zintegrowanego i silnego europejskiego ekosystemu półprzewodników.

Linie pilotażowe mają na celu skrócenie cyklu rozwoju technologii od fazy laboratoriów do produkcji fabrycznej. Umożliwiają testowanie, eksperymentowanie i walidację nowych koncepcji projektowych, co ma przyspieszyć wdrożenie innowacji na rynek. Linie pilotażowe będą dostępne dla szerokiego grona użytkowników, w tym akademii, przemysłu i instytucji badawczych, co ma na celu wzmocnienie europejskiego ekosystemu półprzewodników i zwiększenie konkurencyjności na globalnym rynku.

W ramach implementacji European Chips Act w 2024 roku wybrano konsorcja podmiotów, które będą realizowały projekty czterech nowych linii pilotażowych:

1. Advanced Fully Depleted Silicon On Insulator technologies targeting 7nm.
2. Advanced sub 2nm leading-edge system on chip technology.
3. Advanced Packaging and Heterogenous Integration.
4. Advanced semiconductor devices based on Wide Bandgap materials.

Polskie uczelnie i instytuty wzięły udział w naborze w temacie 2 – Politechnika Warszawska, a w temacie – 4 – sieć Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Polska Akademia Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów zatwierdziło udział polskich uczelni i instytucji naukowych w powyższych naborach.

Innym ułatwieniem przewidzianym we wspomnianym akcie w sprawie czipów jest platforma projektowania czipów w chmurze. Działanie to ma na celu stworzenie pionierskiej europejskiej platformy projektowej w chmurze, która pomoże użytkownikom, w szczególności start-upom i MŚP, w dostępie do szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi, zasobów i usług w celu opracowania ich czipów. Ze względu na znaczące bariery kapitałowe wejścia na rynek projektowania układów scalonych model chmurowy eliminuje potrzebę inwestycji w fizyczną infrastrukturę, co znacząco redukuje koszty początkowe oraz koszty utrzymania sprzętu. Ułatwi to zwiększenie możliwości innowacji w całej branży poprzez obniżenie bariery wejścia na rynek projektowania czipów w Europie.

European Chips Act koncentruje się na zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Europie poprzez budowę nowych fabryk i modernizację istniejących zakładów produkcyjnych. Kluczowym elementem tej strategii jest stworzenie "megafabryk" - nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie niezależności Europy w produkcji półprzewodników. Dzięki temu Europa ma stać się bardziej odporna na zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw i zyskać strategiczną autonomię w kluczowych sektorach technologicznych wykorzystujących półprzewodniki jako komponenty do produkcji innych dóbr.

Kolejnym programem wspierającym rozwój sektora elektroniki i fotoniki jest inicjatywa IPCEI Mikroelektronika i Komunikacja w ramach mechanizmu IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest, pol. Ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania). IPCEI to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji, jakiej poddana jest gospodarka UE.

W ramach IPCEI Mikroelektronika i Komunikacja kraje członkowskie oraz firmy prywatne współpracują nad projektami obejmującymi rozwój zaawansowanych półprzewodników, czujników, układów scalonych oraz systemów wbudowanych. Projekty te mają na celu wprowadzenie na rynek nowatorskich produktów, które będą miały zastosowanie w różnych sektorach, takich jak motoryzacja, zdrowie, przemysł 4.0 oraz technologie komunikacyjne. Współpraca w ramach IPCEI pozwala na dzielenie się wiedzą i zasobami, co przyspiesza proces innowacji i obniża koszty wdrażania nowych technologii.

### **3. Jakie są główne wyzwania związane z rozwojem sektora elektroniki i fotoniki w Polsce, zwłaszcza w kontekście konkurencji międzynarodowej?**

Jako główne wyzwania dla rozwoju sektora elektroniki i fotoniki w Polsce w kontekście konkurencji międzynarodowej należy zakwalifikować:

- możliwości stworzenia odpowiednich warunków dla przyciągania branżowych inwestorów zagranicznych.

Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą "Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych". Celem ustanowienia Krajowych Ram wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych, jest wspieranie inwestycji dotyczących zintegrowanych zakładów produkcyjnych lub otwartych unijnych fabryk w rozumieniu European Chips Act. W ramach European Chips Act przewidziano możliwość udzielenia pomocy publicznej na inwestycje, co jest kluczowym elementem tej strategii. Mechanizmy te pozwalają państwom członkowskim na przekraczanie standardowych limitów pomocy publicznej, co umożliwi większe wsparcie finansowe dla projektów związanych z badaniami, rozwojem oraz wdrażaniem nowych technologii w sektorze półprzewodników.

Inwestycją realizowaną w ramach European Chips Act jest inwestycja firmy Intel w Mliękini pod Wrocławiem. Intel wybrał lokalizację pod Wrocławiem na nowy zakład montażu i testowania półprzewodników. Było to największe wydarzenie w polskim sektorze półprzewodników w 2023 roku. Oczekuje się, że obiekt zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na zdolności montażowe i testowe do 2027 roku. Intel ogłosił plany zainwestowania do 4,6 mld USD w obiekt, który będzie miał możliwość rozbudowy. Po ukończeniu obiekt zapewni możliwości zatrudnienia dla około 2000 pracowników firmy Intel. Będzie to ważny wkład w realizację celu Unii Europejskiej, jakim jest odzyskanie 20% globalnej zdolności produkcyjnej półprzewodników do 2030 r. i inwestowanie w globalny łańcuch dostaw półprzewodników, biorąc pod uwagę, że zakłady związane z ostatnim ogniwem łańcucha wartości są zazwyczaj zlokalizowane poza Europą.

Inwestycja Intela w Polsce, wraz z istniejącym zakładem produkcji wafli w Leixlip w Irlandii i planowanym zakładem w Magdeburgu w Niemczech, może stworzyć kompleksowy łańcuch wartości produkcji półprzewodników w Europie.

Nowy zakład jest również przystosowany do współpracy z zakładem produkcji wafli Intela planowanym w Niemczech i istniejącym zakładem produkcji wafli w Irlandii. Ta bliskość ułatwi ścisłą współpracę między trzema zakładami produkcyjnymi, zwiększając tym samym odporność i efektywność kosztową europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników.

- możliwości zapewnienia pomocy publicznej dla polskich wysokokonkurencyjnych małych i średnich firm mikroelektronicznych i fotonicznych.

Przykładem takiego projektu jest projekt Vigo Photonics, które podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu „HyperPic – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a maksymalna wysokość pomocy publicznej w projekcie wynosi 440,5 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach już wyżej wspomnianego, europejskiego mechanizmu IPCEI Mikroelektronika i Komunikacja. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku.

- możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wysoko kwalifikowanych kadr na potrzeby branży,
- umiejętności sprawnej i efektywnej komercjalizacji osiągnięć naukowych, zwłaszcza z unijnych programów naukowych.

#### **4. Czy rząd podejmuje działania mające na celu zwiększenie inwestycji w infrastrukturę badawczą i produkcyjną w dziedzinie elektroniki i fotoniki?**

Program Funduszy Europejskich na rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oferuje kompleksowe wsparcie finansowe dla sektora półprzewodników i innowacyjności, skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i instytucji naukowych. Program ten przewiduje środki na badania i rozwój (B+R), wdrażanie nowych technologii, rozwój kompetencji pracowników, a także międzynarodową promocję produktów. Program ten promuje tworzenie i rozwój centrów kompetencyjnych oraz infrastruktury badawczej, a także komercjalizację technologii opracowanych na uczelniach i w instytutach badawczych. Dzięki temu możliwe jest wzmacnianie potencjału innowacyjnego polskich MŚP i instytucji otoczenia biznesu, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i dynamicznego rozwoju przemysłu półprzewodników w Polsce.

Rząd podejmuje działania w celu dofinansowania udziału polskich instytutów i uczelni w przedsięwzięciach takich jak linie pilotażowe w ramach naborów ogłoszonych przez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Chipów oraz innych projektów tej organizacji, co zostało szerzej omówione we wcześniejszej części odpowiedzi.

Na przykład – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN w oparciu o dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zapewnienie wkładu krajowego w wysokości 50 mln EUR przystępuje do realizacji ambitnego projektu budowy nowoczesnej linii pilotażowej półprzewodników szerokoprzerwowych. Projekt ten koncentruje się na rozwoju zaawansowanych technologii półprzewodnikowych, które znajdują zastosowanie w kluczowych sektorach takich jak przemysł, motoryzacja, energia odnawialna, elektronika użytkowa oraz obronność. Budowa linii ma rozpocząć się już na początku 2025 roku.

W zakresie inwestycji produkcyjnych – informacje zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 2.

#### **5. Czy istnieją plany rozwoju polskich talentów i specjalistów w obszarze elektroniki i fotoniki, aby zaspokoić potrzeby przemysłu w tym zakresie?**

Przykładem programu w ramach którego w sposób pogłębiony rozwijano kompetencje kadr w dziedzinie mikroelektroniki i fotoniki była prowadzona przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej „Akademia MOEMS”. Dzięki środkom unijnym stworzono unikalną możliwość uzyskania przez zainteresowanych studentów różnych kierunków bardzo rzadkich, wysoce specjalistycznych kompetencji. Program został podzielony na część podstawową i zaawansowaną oferując możliwość uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektach związanych z podstawowymi technologiami półprzewodnikowymi stosowanymi w mikroelektronice i fotonice, metodami modelowania i diagnostyki struktur, elementów i układów scalonych, czy projektowania przyrządów i układów scalonych.

Działania związane z podnoszeniem kompetencji w firmach branży elektroniki i fotoniki mogą również uzyskać dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w konkursie ścieżki Smart w Programie FENG, gdzie został przewidziany odrębny moduł na tego typu wydatki.

Inicjatywy w zakresie rozwoju talentów są również realizowane w bezpośredniej współpracy firm z uczelniami, np. firmy Intel z polskimi uczelniami – w tym z Politechniką Wrocławską.

#### **6. Jakie są perspektywy rozwoju sektora elektroniki i fotoniki w Polsce w najbliższych latach, z uwzględnieniem tendencji globalnych i regionalnych?**

Przyszłość sektora półprzewodników kształtuje się pod wpływem kilku kluczowych trendów, które mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju tej branży.

Pierwszym trendem jest dążenie do zapewnienia odporności łańcucha dostaw. Przemysł półprzewodników, narażony na liczne zakłócenia, potrzebuje budowy bardziej elastycznych i przejrzystych procesów, które umożliwią lepsze prognozowanie i zarządzanie popytem. Jest to kluczowe dla unikania strat finansowych związanych z przerwami w dostawach. Przykładem tego zjawiska jest lokalizacja coraz większej ilości inwestycji związanych z półprzewodnikami poza Azją, głównie w USA i w Europie.

European Chips Act to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu wzmocnienie europejskiego sektora półprzewodników i zwiększenie jego niezależności oraz konkurencyjności na rynku globalnym. Trzeci filar tej ustawy skupia się na zapobieganiu zakłóceniom dostaw poprzez różne strategie i mechanizmy. European Chips Act przewiduje stworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, które będą wspierać budowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej. Te partnerstwa mają na celu przyciągnięcie inwestycji prywatnych oraz zapewnienie finansowania publicznego na strategiczne projekty związane z produkcją półprzewodników. Trzeci filar aktu w sprawie chipów obejmuje również mechanizmy zarządzania kryzysowego, które mają na celu szybkie reagowanie na ewentualne zakłócenia w dostawach. EU planuje utworzenie systemu monitorowania rynku oraz wczesnego ostrzegania, który umożliwi identyfikację potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Mechanizmy te mają na celu minimalizowanie ryzyka przerw w dostawach oraz utrzymanie ciągłości produkcji. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej także podlega opisanym powyżej mechanizmom.

Kolejnym ważnym trendem jest zrównoważony rozwój. Firmy półprzewodnikowe coraz częściej stawiają na ekologiczne praktyki, takie jak wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, inicjatywy związane z oszczędzaniem wody oraz odpowiedzialne metody utylizacji e-odpadów. Przykładem może być Infineon, który planuje zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 70% do 2025 roku i osiągnąć neutralność węglową do 2030 roku.

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) to kolejna rewolucyjna technologia, która ma potencjał znacząco wpłynąć na przemysł półprzewodników. AI wspiera automatyzację zadań, tworzenie kodu oraz odkrywanie leków, co zwiększa efektywność i innowacyjność w produkcji półprzewodników. Integracja AI w procesy projektowania i produkcji pomoże firmom szybko adaptować się do nowych wyzwań rynkowych. Nowoczesne aplikacje sztucznej inteligencji wymagają ogromnych zasobów obliczeniowych. Producentów mikroelektroniki zmusza to do tworzenia procesorów o wyższej wydajności, zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych w krótkim czasie. Na przykład, centra danych wykorzystujące AI muszą obsługiwać skomplikowane algorytmy i analizy danych w czasie rzeczywistym, co wymaga zaawansowanych jednostek obliczeń numerycznych (GPU) i nowoczesnych procesorów.

Technologia Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak, zyskuje na znaczeniu w sektorze półprzewodników. Umożliwia symulację procesów produkcyjnych i urządzeń, co prowadzi do zwiększenia efektywności i zmniejszenia marnotrawstwa zasobów. Dzięki możliwości wizualizacji i optymalizacji procesów na różnych etapach produkcji, Digital Twin wspiera szybsze i bardziej precyzyjne decyzje biznesowe.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym trendem, jest rosnący popyt na półprzewodniki w przemyśle motoryzacyjnym. Wzrost zapotrzebowania na chipy w samochodach, zwłaszcza

w kontekście pojazdów elektrycznych i autonomicznych, napędza innowacje w produkcji półprzewodników. Współpraca między producentami chipów a przemysłem motoryzacyjnym jest kluczowa dla zapewnienia dostaw i wprowadzania nowych technologii na rynek.

**Z upoważnienia, z wyrazami szacunku**

Waldemar Sługocki

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz.1339 z późn. zm. ), w celu udzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie poselskie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np.

podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania tj. do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie poselskie.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.